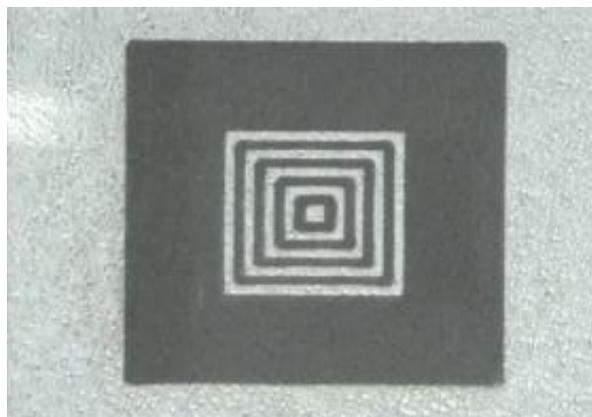


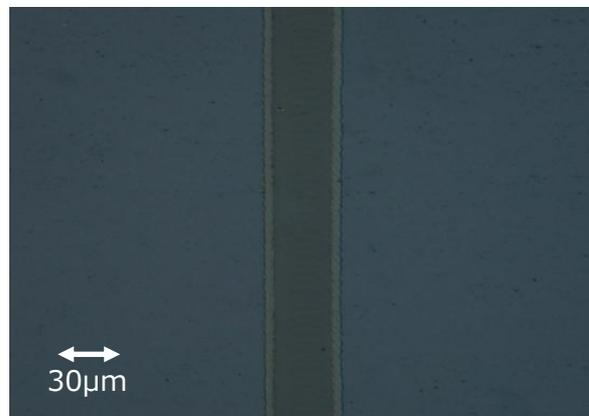
APPLICATION LETTER

● 薄膜、超薄膜へのパターンニング除去加工

① 樹脂上の金属薄膜パターンニング



② ガラス基板上の導電膜除去加工



<加工概要>

- ① 樹脂上の金属薄膜に対しL/S=40 μ m/40 μ mのパターンニング除去加工を行いました。
材料厚みは樹脂(t=20 μ m)金属薄膜(t=1 μ m以下)です。
- ② ガラス基板上の導電体膜に対し30 μ m幅の除去加工を行いました。

<加工技術の説明>

熱影響を極小に抑えた当社独自のレーザー加工技術により
下基板へのダメージを最小限に抑えた成膜除去加工が可能です。
又、スキャニング光学系を使用する事により高スループットを確保致しました。
1 μ m以下の超薄膜に対してもシャープエッジな除去を可能と致します。
除去パターンはプログラミングで変更可能な為、設計変更の度に新規マスクを製作する必要もなく
任意の位置（パターン）で高精度に加工する事が可能です。

<当社のレーザー加工の特徴>

1. 金属薄膜、透明樹脂膜、フッ素樹脂膜など材質を問わず加工する事が可能です。
2. 熱影響が極小の為、除去部周辺にバリやドロスなどの溶融物が発生致しません。
3. 5 μ m程度の極狭幅での除去も可能です。
4. 金属に対しバリの無いシャープエッジの孔加工も可能です。
5. アスペクト比 10 倍以上の孔加工も可能です。（※注 材料と形状によります）



株式会社リプス・ワークス

LPS.Works

〒144-0033 東京都大田区東糀谷 6-4-17

OTA テクノ CORE 409 号室

TEL 03-3745-0330 FAX 03-3745-0331

<http://www.lps-works.com>

E-mail sales@lps-works.com